证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2023-073
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限变更为 20 年的决策主要系根据自身设备实际使用情况，在设备运行满 20 年后在可预见的未来仍可持续稳定运行的情况下做出的，变更原因及时点具备合理性，不存在通过变更会计估计调节利润的情形。但考虑到公司绝大多数同类设备使用年限未满 15-20 年，使用年限超过 15-20 年的半导体硅片专业生产设备占比较小，同时参考同业行可比公司的半导体硅片专用生产设备的折旧期限，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 9 日收到上海证券交易所《关于对杭州立昂微电子股份有限公司会计估计变更相关事项的监管工作函》(上证公函[2023]3310 号)，公司就《工作函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有关问题回复如下：

问题一、相关公告显示，半导体硅片业务系公司主营业务之一，拟变更折旧年限的半导体硅片生产设备净值为 35.67 亿元，占公司全部机器设备、全部固定资产净值的比例分别为 65.44%、52.12%，占 2023 年半年度末公司总资产的比例为 19.81%，金额及占比较大。本次会计估计变更预计减少公司 2023 年度折旧费用 1.19 亿元，预计增加年度归母净利润 0.88 亿元，而 2023 年上半年公司实现扣除非经常性损益前后的归母净利润分别为 1.74 亿元、0.50 亿元，分别同比下降 65.49%、89.00%，相关会计估计变更对 2023 年度损益影响重大。请公司补充披露：(1)半导体硅片生产设备折旧年限相关估计基础的变化情况，包括但不限于设备类型、使用情况、技术及经验变化等，并说明本次会计估计变更原因及时点的依据及合理性，是否符合企业会计准则的相关规定；(2)按完整年度测算本次会计估计变更对 2023 年度利润的影响，并结合 2023 年以来业绩变化趋势说明是否存在通过变更会计估计调节利润的情形。请独立董事、年审会计师发表明确意见。

【公司回复】：

(一)半导体硅片生产设备折旧年限相关估计基础的变化情况，包括但不限于设备类型、使用情况、技术及经验变化等，并说明本次会计估计变更原因及时点的依据及合理性，是否符合企业会计准则的相关规定；

1.半导体硅片专用生产设备折旧年限相关估计基础的变化情况

公司半导体硅片主要产品为抛光片、外延片，根据行业通用程度分为半导体硅片专用生产设备和通用附属设备。抛光片生产制造工序流程为拉晶—切片—磨片-倒角-刻蚀-抛光-清洗-检测，其中拉晶、抛光和检测为制造的核心环节，对应主要专用生产设备为单晶炉、切片机、倒角机、磨片机、抛光机、清洗设备和检测设备等；外延片是在抛光片的基础上通过外延工序所产生，对应主要专用生产设备为外延炉；通用附属设备主要为水电气动力供应、仓储物流设施及其他行业通用性较强的配套设备等。本次会计估计变更对象为半导体硅片专用生产设备，通用附属设备由于行业通用性较强，预计使用年限仍维持 5-10 年不变。

公司于 2001 年完成第一条抛光片生产线的安装调试并转为固定资产，开始批量生产并销售抛光片，于 2002 年 7 月完成外延生产线转固并开始批量生产并销售外延片，构成公司完整的硅片生产线。从公司建立第一条抛光片和外延片完整的生产线起至本次会计估计变更日 2023 年 7 月 1 日共历经 21 年，在此期间公司半导体硅片专用生产设备的总体变化情况如下：

(1)设备类型：由于主要生产流程无变化，主要生产设备仍为单晶炉、切片机、倒角机、磨片机、抛光机、清洗设备、检测设备和外延炉等，生产设备类型无重大变化。

(2)使用情况：公司于 2002 年 7 月构建完成的第一条硅片生产线，后续在实际使用情况中通过更换设备零部件、备品备件、定期维护、更换和改进工艺配方的方式达到维护和延长设备使用年限的目的。旧生产线产出的硅片产出效率、产品合格率和设备使用频率与后续陆续购置的新生产线产出的硅片产品无本质区别，公司 2002 年 7 月构建完成的第一条硅片生产线与后续扩产新增的专用生产设备的使用情况无明显差异。

(3)生产技术及工艺：21 年间，公司硅片产品通过不断的技术更新和工艺配方改进并随着客户需求的发展变化，主流产品由原先的小尺寸 4 英寸、5 英寸硅片，逐步变为了 6 英寸、8 英寸和 12 英寸硅片。硅片产品的工艺流程未发生重大变化，具体的工艺细节为了满足客户新的需求而不断优化。公司 2002 年 7 月构建完成的第一条生产线通过更换设备零部件、备品备件和工艺优化等方式，仍持续稳定的保持连续生产。公司硅片生产技术及工艺的优化升级并未导致相关专用生产设备的主体结构发生明显变化，仍满足现行及可预见未来的相关硅片产品的生产需求。

(4)生产经营经验：根据公司 20 年以来的设备实际使用情况，公司半导体硅片专用生产设备原估计的预计使用年限 10 年已与实际使用情况明显不符，继续使用原会计估计政策已不符合公司的实际经营情况。

综上所述，公司自 2002 年 7 月构建完成的第一条硅片生产线至本次会计估计变更日，半导体硅片专用生产设备的设备类型、使用情况未发生明显变化，生产技术及工艺变化未导致生产设备主体结构发生明显变化，仍满足现行及可预见未来的相关硅片产品的生产流程和工艺，公司会计估计变更主要基于公司实际的经营情况已与原预计的半导体硅片专用生产设备使用年限明显不符所致。

2.会计估计变更原因及时点的依据及合理性，是否符合企业会计准则的相关规定；

(1)会计估计变更原因

公司自 2002 年 7 月构建完成第一条硅片生产线，公司设备类型、设备使用情况、技术工艺等相关会计估计基础虽未发生明显变化，但公司根据实际经营情况，累积了更多经验，发现原预计的半导体硅片专用生产设备使用年限已与实际经营情况明显不符。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，企业根据实际经营情况对半导体硅片专用生产设备折旧年限相关会计估计进行变更。

(2)会计估计变更的时点

公司第一条硅片生产线截止 2022 年 7 月使用已满 20 年，其产出效率及产品合格率与新设备无明显区别，预计设备在未来一段时间内仍可以保持稳定运行、实现稳定产出。公司根据谨慎性原则在第一条硅片生产线运行满 20 年，并仍持续稳定运行满 1 年后进行会计估计变更，故将 2023 年 7 月 1 日作为会计估计变更日，将半导体硅片专用生产设备预计使用年限由 10 年变更为 20 年。

综上所述，公司会计估计变更理由合理，会计估计变更时点依据充分，符合企业会计准则的相关规定。

(二)按完整年度测算本次会计估计变更对 2023 年度利润的影响，并结合 2023 年以来业绩变化趋势说明是否存在通过变更会计估计调节利润的情形。

1.会计估计变更对 2023 年度利润的影响情况

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计自 2023 年 7 月 1 日起执行。

假定会计估计变更分别自 2023 年 1 月 1 日和 2023 年 7 月 1 日执行对公司 2023 年度固定资产折旧和净利润影响如下：(单位：万元)

会计估计变更日	固定资产折旧影响金额	归属于上市公司股东的净利润影响金额
2023 年 1 月 1 日	22,166.63	16,432.99
2023 年 7 月 1 日	11,911.82	8,797.04

2.结合 2023 年以来业绩变化趋势，说明是否存在通过变更会计估计调节利润的情形

(1)2023 年业绩变化情况

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	变动比例(%)
归属于上市公司股东的净利润	17,364.88	50,323.13	-65.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,002.52	45,462.50	-89.00

由上表可见，公司 2023 年 1-6 月较 2022 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润下降 65.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 89.00%，虽同比大幅度下降，但仍保持较高的盈利水平，公司 2023 年 1-6 月的净利润下降的主要原因如下：

①行业景气度下降

2022 年上半年正处于半导体行业景气度的高点，公司产能建设较快，产能释放充分，业绩相对较好。但自 2022 年下半年以来，由于宏观经济不景气、消费电子大幅下滑，半导体行业景气度开始下滑，到 2023 年上半年，情况依旧没有完全好转，全球经济持续疲软、消费需求减弱、地缘政治等多重影响，半导体产业持续低迷。2023 年 6 月 6 日，世界半导体贸易统计协会(WSTS)发布预测称，2023 年全球半导体市场规模将同比减少 10.3%，降至 5,150 亿美元，降幅比之前的预测(减少 4.1%)扩大。根据国际半导体产业协会(SEMI)发布的研究报告，半导体硅片自 2022 年第三季度出货量达到 37.41 亿平方英寸的高位之后，出货量开始遭遇下降，2023 年上半年出货量 65.96 亿平方英寸，较上年同期的 73.83 亿平方英寸下降 10.66%。行业景气度的下滑是公司净利润下降的主要因素。

②可转债发行后相关财务费用支出大幅增加

2022 年 11 月公司发行了 33.90 亿元的可转债导致公司 2023 年 1-6 月增加了 6,235.78 万元的可转债应付债券利息费用。

③公司收购的嘉兴金瑞泓持续亏损

2022 年 3 月公司出于战略考虑收购了嘉兴金瑞泓的控股权，该公司主要生产 12 英寸硅片，目前尚处于产能逐步爬坡和产品客户验证阶段收入较少，同时厂房、设备等固定成本较多，从而导致嘉兴金瑞泓 2023 年 1-6 月亏损 4,726.43 万元。

2020 年 1-6 月、2021 年 1-6 月和 2022 年上半年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 5,504.84 万元、18,385.98 万元和 45,462.50 万元，公司 2023 年 1-6 月的净利润水平虽然相比 2022 年上半年大幅下降仍与 2020 年上半年基本相当，若不考虑发行可转债增加的财务费用和收购嘉兴金瑞泓增加的亏损等因素，公司 2023 年上半年的净利润水平基本与 2021 年上半年相当。

本次会计估计变更虽会导致 2023 年度会计利润增加，但不会改变同比下降的趋势方向，亦不存在通过会计估计变更避免亏损的情形，且本次会计估计变更为未来适用法，不会对公司前期的利润情况造成影响。

综上所述，公司不存在通过变更会计估计调节利润的情形。

【年审会计师意见】：

经核查，我们认为：

1.公司本次会计估计变更理由合理，会计估计变更时点依据充分，符合企业会计准则的相关规定。

2. 公司不存在通过变更会计估计调节利润的情形。

【独立董事意见】：

经查阅注册会计师事务所核查结果底稿，并与公司管理层沟通了解情况。我们认为：公司会计估计变更主要基于公司实际的经营情况，公司会计估计变更理由合理，符合《企业会计准则》的相关规定。公司不存在通过变更会计估计调节利润的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

问题二、公告显示，公司拟将半导体硅片生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年。该类设备在零部件正常更新维护下可使用 20 年以上，公司使用年限超过 15 年至 20 年的同类设备仍在继续使用，且产出效率及合格率与新设备差别不大；但使用年限超过 15 年的半导体硅片生产设备原值仅占公司所有同类设备原值的 4.29%，其中使用年限超过 20 年的仅占 1.45%，绝大多数设备并无超原定折旧年限的使用记录。同时，3 家可比上市公司中，沪硅产业、中晶科技等 2 家公司机器设备折旧年限均为 5-15 年，短于公司经调整后的半导体硅片生产设备折旧年限，其中沪硅产业经营规模与公司较为接近。请公司：(1)量化分析不同使用年限的半导体硅片生产设备的使用情况、更新维护情况及损耗程度等，并说明在绝大多数同类设备使用年限未满 15-20 年的情况下依据少数设备使用情况大幅延长整体设备资产折旧年限的原因、依据及合理性；(2)补充披露调整后的半导体硅片生产设备折旧年限长于多数可比上市公司的原因及合理性，并说明相关会计估计变更是否审慎。请独立董事、年审会计师发表意见。

【公司回复】：

(一) 量化分析不同使用年限的半导体硅片生产设备的使用情况、更新维护情况及损耗程度等，并说明在绝大多数同类设备使用年限未满 15-20 年的情况下依据少数设备使用情况大幅延长整体设备资产折旧年限的原因、依据及合理性；

1.不同使用年限的半导体硅片生产设备的使用情况、更新维护情况及损耗程度等

(1) 不同使用年限的半导体硅片生产设备的使用情况、报废情况(单位：万元)

设备大类	设备类型	主要设备名称	截止 2023 年 6 月 30 日固定资产-机器设备原值		
			已使用超过 20 年	已使用超过 15 年	2023 年 6 月 30 日④
半导体硅片专用生产设备	拉晶设备	单晶炉	1,328.82	4,543.14	63,929.16
	抛光设备	抛光机	1,842.62	3,348.08	160,869.25
	外延设备	外延炉	1,768.43	7,289.74	103,761.23
	检测设备	参数检测仪	1,110.22	2,458.47	116,848.16
	清洗设备	清洗机	304.50	304.50	39,952.01
专用生产设备小计①			6,354.59	17,943.93	485,359.81
通用附属设备②			2,309.00	7,597.62	110,235.26
半导体硅片生产设备小计③=①+②			8,663.59	25,541.55	595,595.07
占 2023 年 6 月 30 日半导体硅片生产设备原值的比例⑤=③/④			1.45%	4.29%	100.00%
不同使用情况的专用生产设备截止 2023 年 6 月 30 日累计报废金额⑥			113.73	333.71	512.95
报废金额占不同使用情况的同类机器设备原值的比例⑦=⑥/①			1.79%	1.86%	0.11%

由上表可知，公司已使用超过 20 年、超过 15 年的半导体硅片生产设备占比占 2023 年 6 月 30 日半导体硅片生产设备原值的比例分别为 1.45%、4.29%，占比均较小，主要系公司半导体硅片业务由浙江金瑞泓、衢州金瑞泓、金瑞泓微电子和嘉兴金瑞泓四个子公司构成，其中衢州金瑞泓、金瑞泓微电子和嘉兴金瑞泓为后续产能提升和产品升级扩建或购买生产线，成立均不足 10 年以上。

(2)各半导体硅片业务公司基本情况

截止 2023 年 6 月 30 日各半导体硅片业务公司基本情况如下：

公司名称	成立时间	半导体硅片专用设备原值(万元)	占比(%)	不同使用年限的半导体专用生产设备占比情况(%)		
				15 年以内	15 年以上	20 年以上
浙江金瑞泓	2000 年 6 月	83,811.70	17.27	78.59	21.41	7.58
其他半导体硅片业务公司	2016 年 12 月后陆续成立	401,548.11	82.73	100.00	-	-
小 计		485,359.81	100.00	97.61	2.39	1.31

由上表可知，公司硅片业务板块子公司浙江金瑞泓自成立之日起已有 23 年，于 2002 年 7 月构建完成第一条硅片生产线，至今已成熟稳定运行 21 年。公司根据浙江金瑞泓成熟良好的经营管理情况和对硅片业务市场前景的展望，根据业务需要为产能提升和产品升级于 2016 年 12 月陆续投资组建了衢州金瑞泓、金瑞泓微电子，收购了嘉兴金瑞泓等其他半导体硅片业务公司，成立均不满 10 年以上。由于后续扩建的生产线在主营产品、设备类型、生产工艺流程上与浙江金瑞泓生产线无明显区别，故公司基于对浙江金瑞泓 21 年的生产设备实际使用情况进行会计估计变更，浙江金瑞泓生产设备使用超过 15 年的占 21.41%，使用超过 20 年的占比 7.58%。

2.半导体硅片生产设备的更新维护情况

公司定期对半导体硅片生产设备主要零部件进行定期检查、更换和保养，根据设备类型的不同检查或更换频率一般为 3-6 月/次，保养频率一般为 6-12 月/次。近 5 年平均更换和保养主要零部件耗用金额占设备原值的 1.50%左右。

3.依据少数设备使用情况大幅延长整体设备资产折旧年限的原因、依据及合理性

截止 2023 年 6 月 30 日，使用年限超过 15 年的半导体硅片专业生产设备原值占公司所有同类设备原值的 4.29%，其中使用年限超过 20 年的占 1.45%，设备类型涵盖公司半导体硅片完整产业链。自公司 2002 年 7 月构建完成第一条完整的半导体硅片生产线起至今 21 年，后续购置的半导体硅片新生产线生产设备的设备类型、使用情况、工艺流程均无明显变化，其产出产品的效率、合格率也无本质区别，故公司依据第一条完整半导体硅片生产线的实际使用情况，对公司同类型的半导体硅片专用设备资产折旧年限进行变更具有合理性。但考虑到公司绝大多数同类设备使用年限未满 15-20 年，使用年限超过 15-20 年的半导体硅片专业生产设备占比较小，基于谨慎性原则，公司决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。

(二) 补充披露调整后的半导体硅片生产设备折旧年限长于多数可比上市公司的原因及合理性，并说明相关会计估计变更是否审慎。

1. 可比半导体硅片行业上市公司机器设备折旧年限情况

证券简称	证券代码	类别	折旧年限(年)
沪硅产业	688126	机器设备	3-15
中晶科技	003026	机器设备	5-15
有研硅	688432	机器设备	5-25
公司(变更后)	605358	机器设备-半导体硅片生产设备	5-20

由上表可知，同行业上市公司定期报告中披露的机器设备最长使用年限介于 15-25 年之间，公司基于同行业上市公司定期报告中披露的最长使用年限判断公司将半导体硅片专用生产设备的折旧年限变更为 20 年后与同行业可比上市公司机器设备使用年限无明显差异。但经向同行业上市公司作进一步的沟通后，了解到同行业部分可比公司的半导体硅片专用生产设备折旧年限均为 10 年，其使用年限介于 15-25 年的机器设备主要为生产辅助设备。

综上，公司将半导体硅片专用生产设备的折旧年限变更为 20 年的决策主要系根据自身设备实际使用情况，在设备运行满 20 年后在可预见的未来仍可持续稳定运行的情况下做出的，具备合理性。但考虑到公绝大多数同类设备使用年限未满 15-20 年，使用年限超过 15-20 年的半导体硅片专业生产设备占比较小，同时参考同业行可比公司的半导体硅片专用生产设备的折旧期限，基于谨慎性原则，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。

【年审会计师意见】：

经核查，我们认为：

公司将半导体硅片专用生产设备的折旧年限变更为 20 年的决策主要系根据自身设备实际使用情况，在设备运行满 20 年后在可预见的未来仍可持续稳定运行情况下做出的，具备合理性。考虑到公司绝大多数同类设备使用年限未满 15-20 年，使用年限超过 15-20 年的半导体硅片专用生产设备占比较小，同时参考同行业可比公司的半导体硅片专用生产设备的折旧期限，公司决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变较为审慎。

【独立董事意见】：

经与公司管理层沟通了解半导体硅片生产线的实际使用情况，我们认为：公司将半导体硅片专用生产设备的折旧年限变更为 20 年的决策主要系根据自身设备实际使用情况做出的。公司基于谨慎性原则，决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变较为审慎。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2023-070
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 19 日(星期四)上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一)审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》

基于谨慎性原则，公司决定取消原于 2023 年 9 月 28 日经第四届董事会第二十二次会议审议通过的将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年的会计估计变更决定，维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分议案的议案》

公司决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变，因此公司 2023 年第二次临时股东大会中取消《关于会计估计变更的议案》。除取消上述议案外，公司 2023 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2023-071
债券代码：111010　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 19 日(星期四)上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

(一)审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》

同意公司基于谨慎性原则，维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：605358　证券简称：立昂微　公告编号：2023-073

杭州立昂微电子股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2023 年 10 月 27 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605358	立昂微	2023/10/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于会计估计变更的议案

2、取消议案原因

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")公司于 2023 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，拟将半导体硅片专用生产设备的折旧年限由 10 年变更为 20 年。现基于谨慎性原则，公司于 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，决定维持现有半导体硅片专用生产设备的折旧年限 10 年不变。因此公司 2023 年第二次临时股东大会中取消审议《关于会计估计变更的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2023 年 10 月 11 日公告的原股东大会延期后的通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 27 日　14 点 00 分

召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号)

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日

至 2023 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司新增 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，详见 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州立昂微电子股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 27 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司新增 2023 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600157　证券简称：永泰能源　公告编号：临 2023-032

永泰能源集团股份有限公司关于所属德泰储能科技(新加坡)有限公司投资新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

永泰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")所属控股公司德泰储能科技(新加坡)有限公司(以下简称"新加坡德泰储能")与新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司 Vnergy Pte. Ltd.(以下简称"Vnergy")签署《投资合作和股东协议》，新加坡德泰储能以 700 万元美元收购和认购 Vnergy 合计 70%股权。

Vnergy 是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公司，主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、制造和销售推广，拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固态储能等技术专利使用权，致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的研发，较目前应用的全钒液流电池产品在热稳定性、能量密度和成本方面均具有明显的行业领先优势。

本次通过新加坡德泰储能投资控股 Vnergy，使公司进一步拥有了行业领先的新一代全钒液流电池储能技术，具备了在热稳定性、能量密度及成本控制等方面的明显优势，将加快实现公司在全钒液流电池储能领域的技术迭代，进一步提升在全钒液流电池市场的盈利能力、核心竞争力和行业地位，推动公司全钒液流电池全产业链发展步伐，加快成为全钒液流电池全产业链领先和龙头标杆企业。

根据《公司章程》的规定，本次投资 Vnergy 事项经公司董事长批准后即可实施。

一、投资概述

为加快公司全钒液流电池全产业链发展步伐，提升在全钒液流电池市场的盈利能力、核心竞争力和行业地位，实现先进储能技术迭代，公司通过所属控股公司新加坡德泰储能与新加坡国立大学全钒液流电池储能科技初创公司 Vnergy 签署《投资合作和股东协议》，由新加坡德泰储能以 700 万元美元收购和认购 Vnergy 合计 70%股权，具体为：新加坡德泰储能以 49.2512 万美元收购 Vnergy 原股东部分股份，以 650.7488 万美元认购 Vnergy 新发行的股份。

本次投资完成后，新加坡德泰储能持有 Vnergy70%股份。Vnergy 负责全钒液流电池储能模块的研发、改进、中试、制造，并注册和取得有关知识产权；新加坡德泰储能负责协助进行中试和商业化应用的推广，且新加坡德泰储能关联方有权优先使用 Vnergy 研发的技术与产品。

2023 年 10 月 19 日，根据《公司章程》的授权，公司董事长批准同意本次投资 Vnergy 事项。根据《公司章程》的规定，本次签署投资协议事项经公司董事长批准后即可实施。

二、合作相关方基本情况

王庆教授，国际知名储能材料研究专家，新加坡国立大学院长讲座教授，新加坡科技研究局 Principal Research Scientist、Vnergy 创始人。2002 年毕业于中国科学院物理所，获得凝聚态物理博士学位。2003-2008 年先后在瑞士联邦理工学院(洛桑，EPFL)及美国可再生能源国家实验室(NREL)从事博士后研究。2008 年入职新加坡国立大学材料科学与工程系，多年来致力于能量转换和储存体系中的介观电荷传输研究，在纳米晶光电化学体系中的电荷转移动力学方面做了系统性工作。近年来在新加坡国立研究基金会的资助下，在国际上首次建立了基于氧化还原靶向反应的研究平台，为规模化的能量储存和转换、退役电池材料的循环利用等提供了新的研究思路。

张军教授，国际知名储能材料研究专家，新加坡国立大学客座副教授和联合博士生导师、Vnergy 联合创始人、股东兼首席执行官。1995 年毕业于中国科学院兰州化学物理研究所，获得物理化学博士学位。2012 年完成新加坡国立大学 EMBA 课程，获得 MBA 学位。先后担任清华大学、兰州大学、南京航空航天大学等多所高校的客座教授和研究员。张军教授曾担任新加坡《时代财智》媒体集团主编，入选中国科学院第二批"百人计划"，拥有 30 多年的先进材料研发和应用领域的经验，曾先后在中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑开放实验室、美国标准技术研究院(NIST)、新加坡科研局(A-Star)制造技术研究院(SIMTech)、数据存储研究院(DSI)等国家级实验室担任科学家和高级研究员，专注于先进材料及表面科学方面的研究开发。近年来，致力于"技术代孕"模式，将实验室专利技术转化为可批量生产的产品技术。

蓝小玲，Vnergy 股东，毕业于南洋理工大学。先后于德勤审计师事务所、Urban Concepts 及 Playboxz、保诚保险任职。

三、标的公司情况

1.企业名称：Vnergy Pte. Ltd.

2.创始人：王庆、张军

3.注册号：202245475M

4.注册资本：1,000 新元

5.成立日期：2022 年 12 月 21 日

6.注册地址：51 Goldhill Plaza #20-07 Singapore 308900

7.经营范围：从事与钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、制造和销售推广。

8.专利：拥有氧化还原液流电池、氧化还原液流金属空气电池、氧化还原液流金属空气电池系统和钒基电解质的容量提升剂 4 项全钒液流电池固态储能核心技术专利。

Vnergy 是一家具备全钒液流电池储能先进技术研发能力的国际化科技公司，主要从事与全钒液流储能相关专利和非专利使用技术与产品的研发、中试、制造和销售推广，拥有创始人王庆教授在新加坡国立大学发明的全钒液流电池固态储能等技术专利使用权，致力于新一代高密度全钒液流电池储能技术和产品的研发。

Vnergy 目前正在开展全钒液流电池电解液增容材料相关先进技术研发，较目前应用的全钒液流电池在热稳定性、能量密度和成本方面均有明显的行业领先优势。因 Vnergy 目前正处于全钒液流电池相关新材料和新技术研发阶段，暂无营业收入和利润。

四、签署相关协议的主要内容

(一)协议主体

1.标的公司：Vnergy Pte. Ltd.

2.标的公司创始人及股东：王庆、张军、蓝小玲

3.投资方：德泰储能科技(新加坡)有限公司

(二)各方的目标

新加坡德泰储能通过收购和认购 Vnergy 股权，在全钒液流电池储能领域获得并保持技术优势地位，以期实现共同开发、全面进入全钒液流储能市场，扩大产品线，增加市场份额，最终促使 Vnergy 发展成为液流电池储能领域领军企业的战略目标。

Vnergy 负责全钒液流电池储能模块的研发、改进、中试、制造，并注册和取得有关知识产权；新加坡德泰储能负责协助进行中试和商业化应用的推广，且新加坡德泰储能关联方有权优先使用 Vnergy 研发的技术与产品。

(三)资本结构

1.Vnergy 通过和新加坡国立大学签署的知识产权许可协议，独家拥有新加坡国立大学所有的 4 项全钒液流电池固态储能技术发明专利。

2.各方同意，新加坡德泰储能出资 700 万美元取得 Vnergy70%股份，主要安排如下：

(1)自本次协议签署之日起 6 个月内，新加坡德泰储能向 Vnergy 投资 700 万美元，具体为：新加坡德泰储能以 49.2512 万美元收购 Vnergy 原股东部分股份，剩余投资款 650.7488 万美元认购 Vnergy 新发行的若干股份(以下简称"新加坡德泰储能初始投资")；

(2)在上述 700 万美元投资完成后，新加坡德泰储能在 Vnergy 持股 70%，原股东在 Vnergy 共持股 30%；

3.作为各方合作和投资安排的一部分，Vnergy 技术团队负责产品设计、设备定型、原材料供应商确认、设备安装、中试基地的设计与建设、产品测试方案的制订、工艺制定与优化、人员培训及产品原型开发，初期审查设计图纸，初期建造施工到现场察视实际设备安装及工艺流程，整套无缝衔接到新加坡德泰储能关联方的中国基地。

(四)生效日

本次协议签署后立即生效。

(五)权利的行使

每一股东应以符合本协议规定的方式行使作为 Vnergy 股东的权利。

(六)董事会

1.除非股东另有书面一致同意，董事人数为 6 名，其中：4 名由新加坡德泰储能和/或其提名的公司指派，相关合作方各指派 1 名董事；每位董事的具体职责和权限由董事会决定。

2.董事会应当有一名董事长。董事长由新加坡德泰储能和/或其提名的公司从其提名的董事中指派。董事长在 Vnergy 的任何董事会会议上在出现同意票和反对票数目相同时，应有权行使第二次投票权或决定投票权。

3.除非新加坡法律另有要求，董事会的所有决议应获得至少 2/3(含 2/3)票数的方式通过。

4.各董事会之所有会议的法定出席人数至少 2 名董事，且其中 1 名董事是由新加坡德泰储能和/或其提名的公司指派的董事。

(七)股东大会

1.股东会议之法定人数为 2 名股东亲自或通过其代表或代理人出席，且其中 1 名